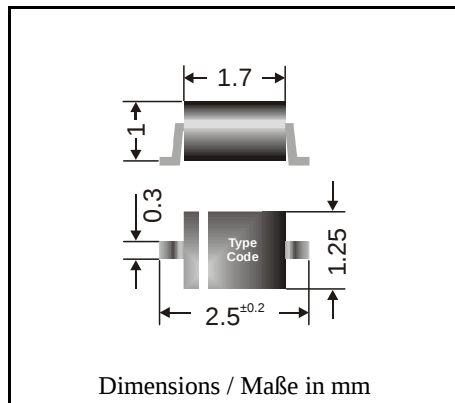


Surface mount Small Signal Diodes Kleinsignal-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2004-04-03



Power dissipation – Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage	70 V
Periodische Spitzensperrspannung	
Plastic case	SOD-323
Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.005 g
Standard packaging taped and reeled	
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

		1N4148WS
Power dissipation – Verlustleistung	P_{tot}	200 mW ¹⁾
Max. average forward current (dc) Dauerstromgrenzstrom	I_{FAV}	150 mA ¹⁾
Peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	$t_p \leq 1 \text{ s}$ I_{FSM}	350 mA
Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung	V_{RSM}	100 V
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	75 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 55...+ 150°C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

Forward voltage–Durchlaßspannung ²⁾		I _F = 10 mA	V _F	< 1 V
Leakage current ²⁾ Sperrstrom	T _j = 25°C	V _R = 20 V	I _R	< 25 nA
		V _R = 75 V	I _R	1 µA
	T _j = 150°C	V _R = 20 V	I _R	< 30 µA
		V _R = 75 V	I _R	< 50 µA

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal

Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

Max. junction Capacitance – Max. Sperrschichtkapazität $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_T	2 pF
Reverse recovery time - Sperrverzug $I_F = 10\text{ mA}$ über / through $I_R = 10\text{ mA}$ bis / to $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}	620 K/W ¹⁾
Marking - Stempelung 1N4148WS	A2 or / oder T4	

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß